

CAMEO Softwares

ANSYS Icepak

---- 电子产品工程师的专业电子产品热分析软件



软件简介

Icepak是面向工程师开发的电子产品热管理CFD软件，基于FLUENT求解器，将先进的求解技术与健全的网格划分选择能力结合起来，为电子器件的冷却提供快速、精确的热量结果。Icepak软件易学易用，不需要设计人员有专业的CFD知识背景。软件内置有大量的电子产品模型、各种风扇库及材料库等，用户只需简单调用即可完成模型设计；从而大大缩短设计周期，节省成本。

应用领域

广泛应用于通讯、航天航空电子设备、电源设备、通用电器及家电等领域,可以解决各种不同尺度级别的散热问题：

- 环境级—机房、外太空等环境级的热分析
- 系统级—电子设备机箱、机柜以及方舱等系统级的热分析
- 板级—PCB板级的热分析
- 元件级—电子模块、散热器、芯片封装的热分析

功能及特点

- 1.快速几何建模功能：友好界面和操作、基于对象建模、各种形状的几何模型、大量的模型库；
- 2.强大的zoom-in功能；
- 3.先进的网格技术：具有自动化的非结构化网格生成能力，具有强大的网格检查功能；
- 4.参数化和优化设计功能：；
- 5.丰富的物理模型：自然对流、强迫对流和混合对流、热传导、热辐射、流-固的耦合换热、层流、湍流、稳态、非稳态等流动现象；
- 6.强大的解算功能：FLUENT求解器、结构化与非结构化网格的求解器；
- 7.强大的可视化后置处理。

